



EXPERT 10.6 HXV

Reworkstation mit 5300 W

Reworkstation mit 5300W Heizleistung in Hybrid-Technologie auf 450x420 mm². Heizfläche passend zur LP Abmessung einstellbar. Automatisches Platzieren der SMD Bauteile mit Auto-Vision-Placer (AVP) inkl. EASYSOLDER 07 Softwarepaket und DBL 06 Steuergerät

mit sechs hochauflösenden Temperaturmesseingängen (Typ K). Dieses Gerät ist besonders geeignet für große, mehrlagige Leiterplatten von PCs, Laptops und Serverboards mit kleinen bis sehr großen Bauteilen.

Top Features

Kameragestütztes Rework



Flexibilität

verschiedene PCB Größen und Formen sowie Bauteile möglich bis zu 75 x 75 mm



Unterheizung

Große PCBs 500 x 500 mm



Performance

Uniforme Wärmeverteilung durch Konvektions- und Hybridtechnologie



Multifunktionalität

Alle Prozesse an einem Gerät: Lot Absaugen, autom. Positionierung, Löten und Entlöten



Prozesskontrolle

Automatischer Profiler für Unter und Oberheizung

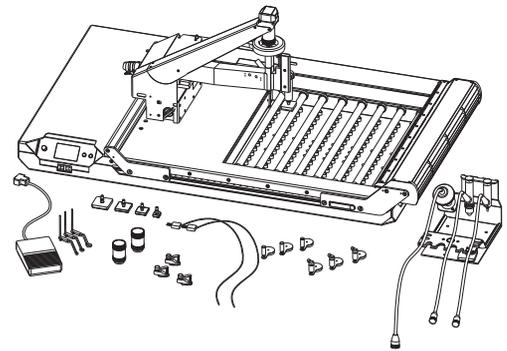


Software

einfach, intuitiv, Tablet kompatibel

Ausstattung

- Arbeitsgriffel mit Magazinständer: Dosieren, Bestücken, Altlotabsaugen, Löten.
- Satz Bestück Pipetten XL (BGA/CSP) 5 mm, 8 mm, 15 mm mit O-Ring
- Satz Löt-Werkzeuge (BGA) 15 mm, 27 mm, 35 mm, 40 mm
- Zwei Objektive (BGA und CSP)
- Zwei Sensoren (Typ K) für Temperaturmessung
- Sechs Leiterplatten-Magnethalter 40,5 mm (3x Standard, 3x Easy-Lock)
- Drei Leiterplattenklammern zur Montage an der Handauflage
- Fußtaster
- Rework ABC und Betriebsanleitung
- Intuitive touchfähige Software EASYSOLDER 07



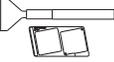
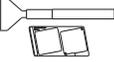
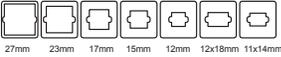
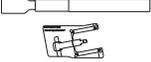
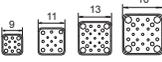
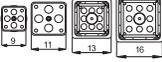
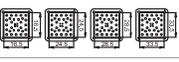
Technische Details

Gesamtleistungsaufnahme:	5500 VA	
Leistung Lötgriffel:	300 W, 35 l/min	
Leistung Unterheizung:	1200 - 5000 W	8 x IR-Lampen
Größe Unterheizung:	450 x 420 mm ²	
Empf. max. Leiterplattengröße:	480 x 480 mm ²	
Auflösung Positionierachsen:	0,001 mm	
Platziergenauigkeit:	± 0,015 mm	(Flip Chip)*
	± 0,030 mm	(CSP)
	± 0,040 mm	(BGA)
	± 0,070 mm	(Maxi BGA)*
	± 0,115 mm	(Maxi BGA XL)*

Hochaufl. CMOS-Kamera:	5 Mio. Pixel USB2	
Bildausschnitt:	16 x 22 mm ²	(Flip Chip)*
	32 x 42 mm ²	(CSP)
	42 x 57 mm ²	(BGA)
	71 x 96 mm ²	(Maxi BGA)*
	115 x 160 mm ²	(Maxi BGA XL)*
Elektrischer Anschluss:	1Phase, 230VAC, 25A	Stecker CEE 32A (3-phasig)
Druckluft:	5-8 bar, 100 l/min,	gereinigte, trockene Luft
Systemabmessungen:	1030 x 630 mm ²	

*Ergänzungsbaustein

EXPERT 10.6 HVV: Ergänzungsbausteine

	Artikel nr.	Name
	DVSX.0007	Report mit LP-Identifikation für ES-05, Lizenz RP
	SF71.0002	IR-Temperatursensor für AVP04.1XL
	SF66.0501	Tool Slider 40 für AVP 4.1XL
	SF64.0525	Dipp Tool 0,08mm mit Raker für Tool Slider 32 / 40
	SF64.0526	Dipp Tool 0,15mm mit Raker für Tool Slider 32 / 40
	SF64.0527	Dipp Tool 0,22mm mit Raker für Tool Slider 32 / 40
	SF66.0526	Dipp Tool 40x0,15mm mit Raker nur für Tool Slider 40
	AT10.0100	Chip Rahmen Set Dipp Tool 7 / 32*32mm 7 Stück (11x14,12x18,12,15,17,23,27)
	AT20.0100	Chip Rahmen Set Dipp Tool 7 / 40*40mm 7 Stück (15,17,23,27,31,35,37,5)
	SF64.0520	Print Tool mit Raker für Tool Slider 32 / 40
	DB00.0025	Stickstoff-Anschluss DBL-04/05/06 (2.D.M) verringert N2-Verbrauch bei Vakuum
	SF66.0110	Objektiv Maxi-BGA für AVP4/4XL, f=16mm, 65*85mm
	LW40.1096	Löt-Werkzeug-Set-CSP/QFN für alle CSP-Typen, 4 Stück (9, 11, 13, 16)
	LW40.1104	Löt-Werkzeug-Set CSP mit Vakuum für alle CSP-Typen, 4 Stück (9, 11, 13, 16)
	LW40.1099	Löt-Werkzeug-Set BGA 7 7 Stück (15, 23, 27, 31, 35, 37.5, 40)
	SF36.1002	Leiterplatten-Flex-Unterstützung 40,5 für HIF-9-Strahler, 12-Punkt-Kissen
	SF71.0005	Seitenkamera (Objektiv 16mm) für ES-05, Kamera, Ständer, Kabel, DVD
	SF71.0008	Objektiv Seitenkamera f=35mm

Weiteres Zubehör und Verbrauchsmaterial unter www.martin-smt.de